

2023 年國巨前瞻被動元件專題論文競賽

摘要投稿公告-請投稿者務必觀看

壹、徵稿主題

- 一、電子陶瓷元件及介電, 絕緣, 磁性材料
- 二、高頻通訊元件及低溫共燒陶瓷材料
- 三、陶瓷保護元件或功能陶瓷元件及材料
- 四、被動元件封裝技術及材料
- 五、被動元件相關之製程、可靠度測試、分析技術與其前瞻應用
- 六、車用電子元件及材料
- 七、Sensor 元件及材料

貳、基本規定

- 一、中、英文標題與作者資訊標於首頁，作者資訊包含：姓名、單位、職稱(例如：陳小美國立成功大學化工系碩士生)、聯絡信箱。
- 二、中文字型為標楷體，英文字型為 Times New Roman，字體大小為 12 號，段落行距中文為 1.5 倍行距，英文為二倍間距(double space)，對齊方式為左右對齊，使用紙張大小為 A4 直式，以直式橫書，電子檔案請以 Microsoft Office Word 編寫。
- 三、摘要：中、英文摘要各繳交一頁(分別標於第二頁、及第三頁)，中文摘要以 500 字為限、英文摘要以 300 字為限。

參、投稿規定

- 一、摘要投稿請於 112 年 04 月 30 日前上傳至 Google 表單 <https://reurl.cc/ZXVq8l>，為避免因傳送過程錯誤而影響您的權益，請務必於摘要檔案名稱上註明『投稿方式、投稿者姓名、中文標題』檔名名稱請參考範例：口頭發表-陳小美-封裝技術之分析與應用。